胜科纳米(苏州)股份有限公司

公司代码:688757 公司简称:胜科纳米

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、2025年度利润分配预案:公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.62元(含税),截至本报告披露日,公司总股本403,311,486股,以此计算合计拟派发现金红利25,005,312.13元(含税)。本次不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、2025年中期利润分配:公司已于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议、于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)。2025年11月公司完成了2025年中期现金红利的派发,实际派发现金红利20,165,574.30元(含税)。

综上,本年度公司现金分红合计为45,170,886.43元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为73.00%。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	胜科纳米	688757	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周秋月	吴萍
联系地址	苏州工业园区朝前路9号	苏州工业园区朝前路9号
电话	0512-62800787	0512-62800787
传真	0512-62800007	0512-62800007
电子信箱	IR@wintech-nano.com	IR@wintech-nano.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务基本情况

公司是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室,主要服务于半导体客户的研发环节,可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验。半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节,检测分析实验有助于加速客户研发进程,提升产品性能指标及良品率,在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。公司通过专业精准的检测分析服务,判断客户产品设计或工艺中的缺陷,助力客户提升产品良率与性能,成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台,承担辅助客户研发的重要角色。凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力,公司可以协助客户解决产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症,被形象地喻为"芯片全科医院"。

公司深耕半导体检测分析行业多年,检测分析实验覆盖范围广泛全面,掌握的检测分析技术应用于集成电路、分立器件、光器件、传感器、显示面板等众多领域,客户类型覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等半导体全产业链。通过精准可靠的检测技术,全面多元的测试项目,高效及时的响应速度,有效完善的研发体系,优质丰富的客户资源以及市场口碑的营销服务网络,公司在半导体检测领域形成了突出的品牌效应,目前已累计服务全球客户2,000家。

2、主要产品或服务的基本情况

公司主要服务于客户的研发环节,公司通过各类型分析实验为客户高效地解决研发期间所面临的产品设计缺陷、工艺改良、性能提升等问题,进一步加速客户的研发进程。目前公司的检测分析实验主要包括以下类别:

类型	主要分析实验内容	主要分析实验项目类别	典型分析实验项目
失效分析	主要指通过实验分析手段确定元器件既有的失效现象的原因及失效机理,或判断可能存在的失效情况; 公司提供的失效分析实验除为探究样品失效原因的检测分析外,还包括为发现潜在失效问题、确保工艺稳定实施的破坏性物理分析(DPA); 针对具体的失效分析案件,公司通常根据样品特点及客户需求进行检测分析方案设计,综合运用多类型失效分析检测项目,还可能结合材料分析检测项目,最终为客户呈现该案件的检测分析结果	无损检测分析	超高分辨率光学检测分析,超声波扫描检测分析,常规X射线无损检测分析,纳米CT无损检测分析等
		电性检测分析	电流-电压曲线特性测量,品体管极电性参数测量,红外热成像显微检测,微光光电成像分析,红外激光热阻测量等失效定位分析等
		物性检测分析	样品制备包括开封制样、去层制样、研磨制样、聚焦离子束制样加工等;样品检测分析包括扫描电子显微形貌成像分析、芯片线路修改、材料分析等
材料分析	主要指通过实验分析手段对样品进行材料成分及结构的分析,实现对样品的结构组织分布、元素比例构成、污染物情况等的深入分析判断	表面分析	X光电子成分及价态分析,原子力表面形貌分析,飞行时间二次离子质谱分析,动态二次离子质谱分析,傅里叶有机物光谱分析等
		微区结构成分分析	透射电镜微观结构表征等
可靠性分析	考察特定实验条件下产品的寿命特征、环境适应能力等,确定特定条件下产品的可靠性水平	环境测试	高低温冲击试验、高加速寿命试验、高低温湿热试验、高温存储试验、高温供电测试等
		老化测试	高温工作寿命试验、低温工作寿命试验、高温高湿反向偏压老化试验、高温栅极偏压老化试验等
		静电测试	传输线脉冲静电测试、人体放电模式静电测试、组件充电模式静电测试等

2.2 主要经营模式

1、盈利模式及实验室多点布局模式

公司主要从事半导体第三方检测分析服务,主要服务于半导体客户的研发环节,具体包括样品失效分析、材料分析及可靠性分析等检测实验,公司通过向客户提供第三方检测分析服务实现收入和利润。公司目前在新加坡、苏州、南京、福建、深圳、青岛、北京等地多点布局实验室,多点建设实验室的业务模式是基于公司总体战略布局、重点客户服务需求,按照行业惯例做出的经营决策。

2、采购模式

公司主要采购分析仪器、实验耗材以及委托检测服务等。分析仪器主要为开展检测分析的专用仪器设备;实验耗材则通常包括满了源等设备配件、化学试剂、砂纸、载台具等,用于辅助完成检测分析。公司对外采购委托检测服务,主要系在出现临时性设备检测产能紧缺或面对少量超出日常检测能力范围的检测项目时委托第三方检测服务机构完成部分检测项目。

公司严格遵守《采购管理制度》等公司规章制度。采购活动一般由业务部门首先提交需求,并同采购部报送采购申请单。采购部在获取业务部门采购需求后,进行供应商准入调查,随后采购部结合市场报价确定最终供应商。经相关负责人审批后,公司按照合同管理制度,与供应商签订采购合同,并根据实际需求进行采购。

3、服务模式

公司主要采用以销定产的生产模式,实行订单式生产。公司根据样品情况及客户需求进行个性化的检测分析方案设计,并按照测试方案对样品进行检测,最终向客户发送检测结果报告。公司建立了多维度的生产管理制度和考核机制,重点关注测试质量与效率,并根据达成情况不断调整、优化生产过程,确保公司测试服务质量的持续提升。

4、销售模式

公司的销售模式为直销模式,直接面向客户提供服务。公司通过自身积累的半导体产业链先进检测技术与分析经验,以专业高效的检测分析能力为基础,实现客户管销,并深度挖掘客户各阶段的检测分析需求,为客户定制检测分析方案,随时响应客户检测需求。

公司目前已建立一支营销能力强、专业经验丰富的市场销售团队,通过直接洽谈、客户引荐、会议论坛等方式获取资源,公司客户已覆盖全国及东南亚等国外地区。公司已制定《业务管理制度》,针对各客户建立基本信息表,就客户的需求变动随时进行跟进。在销售定价方面,公司销售人员以公司内部制定的各类测试服务收费标准作为参考,与客户协商确定订单价格。同时,公司综合客户付款方式、资金实力、信誉状况、合作情况等给予客户不同的信用期。

5、研发模式

公司建立研发部门,下设方案设计部、工艺研发部、前沿技术部以及智能数据部四个研发小组,并按照《研发管理制度》等规范要求进行研发流程管理。公司以自主研发为主,以市场需求和行业发展趋势为导向,持续开展研发创新活动,同时将AI技术深度融入研发流程,以智能化手段赋能研发管理与技术创新,提升研发效率与成果质量。

基于公司业务的特点,公司研发活动具体分为立项、开展与结项阶段。在立项阶段,公司研发人员根据前期调研以及市场需求提出研发课题建议,组建项目团队并形成《研发项目立项报告》,经立项评审委员会审批通过后正式立项。在项目开展阶段,公司各研发项目负责人根据《研发项目立项报告》及《研发开发项目立项决议》确立的项目内容、范围、进度,具体开展研发活动,参与研发活动的人员根据研发项目参与情况每周对工时及机时进行填报,经研发项目负责人及研发总监两级审批后,提交财务部进行汇总核算。在结项阶段,项目负责人提交研发项目的结项报告,公司组织内部评审会议,经研发总监和公司总经理验收后,项目完成结项。

2.3 所处行业情况

报告期内,公司所处主要行业发展阶段、基本特点及主要技术门槛情况说明如下:

(1)行业发展阶段

伴随人工智能、5G等前沿技术持续突破,半导体芯片需求持续增长,技术迭代与产品升级共同催生了新的应用场景与商业模式。半导体检测分析服务是半导体产业链中的重要环节,直接影响了芯片研发效率、产品良率和可靠性,随着半导体产业的蓬勃发展与技术升级,半导体检测分析需求持续提升,产业整体已步入高速发展阶段。

(2)基本特点

半导体第三方实验室检测分析具有技术领先、立场客观的特点,对于芯片设计、晶圆制造、芯片封装等过程中存在的问题,需要结合物理、化学、结构、材料等多学科知识,运用包括物性分析、电性分析、表面分析、化学分析等在内的多类型检测技术,及时地给出中立、公正的反馈,提出专业高效的建议。

公司创造性地提出了"Labless"理念,即半导体企业将失效分析等检测分析工作更多地交由专业第三方实验室执行的模式。Labless是Lab(实验室)与Less(无,没有)的组合,是"无自建实验室"的运作模式,在现阶段半导体产业发展中也涵盖了"轻实验室"模式,即未购置大量检测分析实验设备而主要委托第三方进行检测,与厂内自建实验室In-House Lab模式相对,Labless概念近年来已逐步受到市场认可。

与厂内自建实验室的In-House Lab模式相比,Labless模式具有如下特点:

① 经济性:高端检测设备的高昂成本制约了厂内实验室的发展,Labless模式可有效降低客户成本

失效分析等检测分析对设备仪器的高精度与设备品类的多元化要求较高,与IDM模式下制造厂商面临的高额产线投入成本问题较为类似,高端检测设备的高昂投入成本也制约了厂内实验室的发展。

一方面,高端检测设备的单台设备价值量高,厂内实验室通常无法拥有配置覆盖全方位检测需求的检测分析设备的资金实力;另一方面,厂内实验室的检测需求与自身的研发周期、调试周期息息相关,厂内实验室可能面临研发时或试生产时慢发式的检测分析需求,亦可能面临产能闲置的情况,无法达到资源的有效利用。因此,采用Labless模式将检测分析需求委托至第三方检测机构可有效降低客户成本。

② 专业性:半导体第三方实验室检测分析具备更强的专业化、多元化的检测分析技术与人才

半导体实验室检测分析需要运用电子、结构、材料、理化等多学科知识,半导体产业链总体面临人才短缺的问题,而在短时间内运用复杂技术手段对样品问题进行检测分析的综合性技术人才亦属于行业内稀缺资源。

相较于第三方实验室专家团队所具备的丰富检测案例经验、综合分析技术,厂内检测分析人才通常局限于自身半导体产业环节,如封装厂商的工程师聚焦于封装环节,对于晶圆制造工艺的技术掌握程度有限,这可能导致其在分析失效样品时无法有效判断晶圆制造环节内含的缺陷。第三方检测分析实验室则拥有产业链各环节技术人才,具备覆盖全产业链的分析能力,并通过长时间案件检测的经验积累,不断精进检测分析技术,以专业的检测分析能力与时效性赢得客户的信赖。

③ 中立性:独立的半导体第三方检测分析实验室提供客观、公正的建议

由于半导体产品的缺陷可能来自产业链的各个环节,除芯片设计、晶圆制造、封装测试外,上游原材料、半导体设备以及终端厂商均有可能导致产品质量问题的出现,相较于厂内自建实验室对于产品的检测分析,中立的第三方实验室可提供更为客观与公正的检测分析实验,用准确的分析结果帮助企业快速溯源失效根因,为客户的产品设计及制造工艺优化提出解决建议。

(3)主要技术门槛

① 技术壁垒

半导体检测分析机构掌握的各类检测技术是开展检测分析的基础。随着国内半导体和集成电路产业的发展,尤其是近年来汽车智能化、网联化、电动化等趋势的快速发展,对半导体产品的安全性、可靠性要求愈加严苛,半导体制造过程的低容错率也对检测分析提出了更高的要求。

公司已深度掌握各类型检测理论与操作技术,可根据样品的失效情况与检测需求选择适当的检测分析项目,高效精准地实现客户的特定检测需求,同时,公司掌握针对各类型案件进行定制化检测分析方案设计的能力。此外,由于失效样品数量极少,为避免引入新的缺陷给结果造成失效分析失真,在检测分析过程中公司掌握的样品制备能力也显得至关重要。

行业新进入者往往很难在短时间内形成有竞争力的检测技术,这使得行业具有较高的技术门槛,对潜在的市场进入者构成了壁垒。

② 人才壁垒

半导体第三方检测方案的设计涉及样品制备、成像分析、失效分析、材料表征、可靠性分析、整合方案等多个专业领域,需要专业技术人员拥有包括电子、结构、材料、理化在内的多方面理论知识与实践技术储备。

具体就公司业务开展对专业技术人员的要求而言,研发人员通常为综合能力强的较高学历人才,在掌握半导体检测分析实践经验的基础上,需了解半导体产业链各环节的相关工艺技术,同时需具备快速学习能力与行业前瞻分析能力,及时跟进半导体产业技术迭代与发展,并对未来行业所需检测分析技术进行前沿调研及分析。公司拥有的生产技术人员同样需具备相应的半导体检测分析理论知识及学历门槛,在了解理论知识的基础上,通过实践培训掌握检测分析技术,实现高效精准的上机操作。因此,半导体检测分析行业对技术人员的实践操作能力要求较高,需要通过一定时间的积累或密集高效的专业培训来掌握专业技术。

目前,国内半导体检测行业的整体技术水平与发达国家还存在一定差距,行业内高素质人才相对短缺且高端人才培养很难在短期内快速实现,技术人员也需要一定时间的经验积累或借助行业内成熟企业内部高效的培训积累经验,这对新进入企业构成了一定的专业人才壁垒。

③ 客户认证壁垒

对于新进入者而言,快速获取稳定的客户资源是进入该行业的主要壁垒之一。检测业务对服务提供方的保密性、服务质量、服务效率等方面要求较高。半导体检测行业主要客户群体涵盖国内外一线龙头,在第三方测试服务商选择时通常需要进行严格的资质验证,合作前对供应商的生产能力、产品工艺、质量、技术水平等进行充分考核。由于更换服务提供方需面临较大的质量控制风险并承担时间成本,因此客户倾向于与检测机构形成长期、稳定的合作关系。市场新入者需要更大的投入才能成功创立新的品牌和突破市场已有的品牌壁垒,且很难在短时间内建立忠诚度。

④ 资质认证壁垒

公司从事半导体第三方检测分析实验,由于检测分析数据将对下游客户的研发试制、产品性能、生产效率等带来重要影响,因此从事第三方检测分析的实验室通常需要获得权威认证机构颁发的资质,以获得下游客户的信赖和认可。同时,在合作过程中客户亦通常要求企业具备一定的相关资质,如满足CNAS实验室认可和CMA资质认定证书等。CNAS实验室认可和CMA资质认定证书等相关资质需要检测机构具备一定时期的检测业务经验、认证要求较高,对新进入检测行业的企业形成一定的资质壁垒。

⑤ 资金壁垒

半导体检测行业对资本规模和资金实力有较高需求。半导体检测服务之过程主要是依赖不同功能的分析设备执行精细的分析作业。由于半导体制程精密,产品功能复杂,行业需要客集客本投入促进检测设备更新换代。另一方面,由于半导体行业技术更新较快,检测分析技术研发的时间周期长,企业为了保持技术的与时俱进,需要持续进行高额的研发投入,以满足下游的更新换代需求,为行业构筑了一定的资金壁垒。

公司创造性地提出了"Labless"理念,Labless是Lab(实验室)与Less(无,没有)的组合,是"无自建实验室"的运作模式,在现阶段半导体产业发展中也涵盖了"轻实验室"模式,即未购置大量检测分析实验设备而主要委托第三方进行检测,与厂内自建实验室In-House Lab模式相对,Labless概念近年来已逐步受到市场认可。

与厂内自建实验室的In-House Lab模式相比,Labless模式具有如下特点:

① 经济性:高端检测设备的高昂成本制约了厂内实验室的发展,Labless模式可有效降低客户成本

失效分析等检测分析对设备仪器的高精度与设备品类的多元化要求较高,与IDM模式下制造厂商面临的高额产线投入成本问题较为类似,高端检测设备的高昂投入成本也制约了厂内实验室的发展。

一方面,高端检测设备的单台设备价值量高,厂内实验室通常无法拥有配置覆盖全方位检测需求的检测分析设备的资金实力;另一方面,厂内实验室的检测需求与自身的研发周期、调试周期息息相关,厂内实验室可能面临研发时或试生产时慢发式的检测分析需求,亦可能面临产能闲置的情况,无法达到资源的有效利用。因此,采用Labless模式将检测分析需求委托至第三方检测机构可有效降低客户成本。

② 专业性:半导体第三方实验室检测分析具备更强的专业化、多元化的检测分析技术与人才

半导体实验室检测分析需要运用电子、结构、材料、理化等多学科知识,半导体产业链总体面临人才短缺的问题,而在短时间内运用复杂技术手段对样品问题进行检测分析的综合性技术人才亦属于行业内稀缺资源。

相较于第三方实验室专家团队所具备的丰富检测案例经验、综合分析技术,厂内检测分析人才通常局限于自身半导体产业环节,如封装厂商的工程师聚焦于封装环节,对于晶圆制造工艺的技术掌握程度有限,这可能导致其在分析失效样品时无法有效判断晶圆制造环节内含的缺陷。第三方检测分析实验室则拥有产业链各环节技术人才,具备覆盖全产业链的分析能力,并通过长时间案件检测的经验积累,不断精进检测分析技术,以专业的检测分析能力与时效性赢得客户的信赖。

③ 中立性:独立的半导体第三方检测分析实验室提供客观、公正的建议

由于半导体产品的缺陷可能来自产业链的各个环节,除芯片设计、晶圆制造、封装测试外,上游原材料、半导体设备以及终端厂商均有可能导致产品质量问题的出现,相较于厂内自建实验室对于产品的检测分析,中立的第三方实验室可提供更为客观与公正的检测分析实验,用准确的分析结果帮助企业快速溯源失效根因,为客户的产品设计及制造工艺优化提出解决建议。

(3)主要技术门槛

① 技术壁垒

苏州德开元泰投资管理有限公司	0	7,442,679	1.85	7,442,679	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			李晓旻与江苏凌翔技术咨询有限公司及苏州禾芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

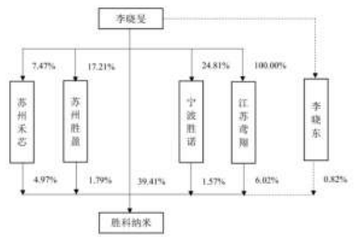
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

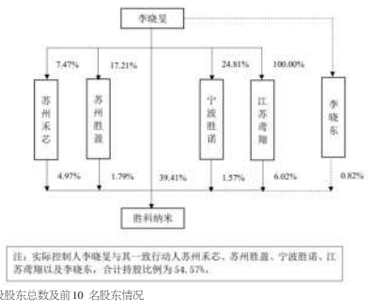
√适用□不适用



注:实际控制人李晓旻与其一致行动人苏州禾芯、苏州胜蓝、宁波胜诺、江苏凌翔以及李晓东,合计持股比例为54.57%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



注:实际控制人李晓旻与其一致行动人苏州禾芯、苏州胜蓝、宁波胜诺、江苏凌翔以及李晓东,合计持股比例为54.57%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入52,952.73万元,较上年同期增长27.51%;归属于上市公司股东的净利润为6,187.90万元,较上年同期下降23.78%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,617.11元,较上年同期下降22.54%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688757 证券简称:胜科纳米 公告编号:2026-014

胜科纳米(苏州)股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,现将胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1870号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票40,331,149股,每股发行价格为9.08元,募集资金总额为人民币36,620.68万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币29,659.84万元。上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年3月20日出具的《验资报告》(中汇会验[2025]2110号)审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为3,604.29万元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年3月20日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	36,620.68
减:直接支付发行费用	6,960.84
二、募集资金净额	29,659.84
减:	
本年度使用募集资金置换预先投入募投项目	21,567.18
本年度实际投入募投项目	4,538.41
暂时补流金额	0.00
现金管理支出金额	17,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.09
加:	
募集资金利息收入	3.46
现金管理赎回金额	17,800.00
现金管理收益	39.25
尚未支付的发行费用	7.42
三、报告期期末募集资金余额	3,604.29

注1:以上合计项与分项之和存在尾差系四舍五入所致;

注2:2026年3月,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"苏州检测分析能力提升建设项目"已达到预定可使用状态;截至本报告出具日,公司已将首次公开发行股票募集资金账户注销,并将节余资金748.96万元转至自有资金账户,用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、管理、使用情况做出了明确的规定,保证募集资金的规范使用。

2025年2月,公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年3月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
胜科纳米(苏州)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040040239	102.69	使用中
胜科纳米(苏州)股份有限公司	兴业银行苏州分行营业部	206610100101172544	2,955.95	使用中
胜科纳米(苏州)股份有限公司	浦发银行苏州分行营业部	89010078801600009325	545.65	使用中
合 计	–	–	3,604.29	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目投入金额为26,105.58万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目资金投入及置换情况

1、募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用1,586.30万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,567.18万元,合计为23,153.48万元。保荐人华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。上述置换已于2025年4月14日完成。

2、募投项目实施过程中募集资金等额置换情况

由于公司募投项目存在需向境外供应商支付外币采购分析仪器、实验耗材,以及需支付海关进口增值税等税款的情况,公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后,使用自有外汇、自有资金预先支付募投项目相关款项,后续定期以募集资金金额等额置换。保荐人华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。

报告期内,公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有外汇、自有资金的金额为3,306.15万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不涉及以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币9,000.00万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2025年3月20日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
9,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)		2025年4月9日	2026年4月8日	2025年4月9日	

2025年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份									
募集资金到账时间			2025年3月20日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	收益金额
胜科纳米(苏州)股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	4,500.00	2025/4/14	2025/5/22	2025/5/22	0	2.13%	10.12
		兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	500.00	2025/4/16	2025/5/24	2025/5/24	0	2.08%	1.10
	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	"汇利丰"2025年第5497期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2025/4/21	2025/5/19	2025/5/19	0	0.97%	0.75
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行营业部	利多多公司稳利25JG3151期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,800.00	2025/4/14	2025/7/14	2025/7/14	0	2.03%	14.35
		利多多公司稳利25JG3317期(月月利特供款B)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	0	1.95%	4.55
		利多多公司稳利25JG3378期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/9/15	2025/10/15	2025/10/15	0	1.70%	4.25
		利多多公司稳利25JG4132期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/11/10	2025/12/10	2025/12/10	0	1.65%	4.13

(五)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不涉及节余募集资金的使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。公司实际募集资金净额29,659.84万元,低于《胜科纳米(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额,调整后拟投入募集资金金额为29,659.84万元。保荐人华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,胜科纳米公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了胜科纳米公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:2025年度,胜科纳米募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金金额使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的行为。

特此公告。

胜科纳米(苏州)股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年3月20日											
本年度投入募集资金总额	26,105.58											
已累计投入募集资金总额	26,105.58											
变更用途的募集资金总额	–											
变更用途的募集资金总额比例	–											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	本年度投入金额	本年度投入金额占比(%)(5)=(2)/(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日期)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况
苏州检测分析能力提升建设项目	生产建设	–	29,691.46	29,659.84	29,659.84	26,105.58	26,105.58	-3,554.26	88.02	2026年3月	不适用[注1]	不适用	否	
合计			29,691.46	29,659.84	29,659.84	26,105.58	26,105.58	-3,554.26	88.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(二)募投项目资金投入及置换情况"													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中